

iC-HG 评估板选型表

评估板	可用封装类型
HG1D	用于引线封装的通用评估板；可能不会达到 iC-HG 的最大开关速度，具体取决于工作点、实际布线和封装
HG2M	用于 C-mount 封装的高速模块
HG8M	用于 TO 型或其他引线封装（如：蝶形）的高速模块；有效开关速度取决于封装电感
HG20M	用于 SMD 封装（如：用于高功率 VCSEL 阵列）的高速模块
HG21M	用于具有可供替代焊盘布局的 SMD 封装的高速模块
HG2D	主机适配器，可轻松处理上述高速模块并轻松安装散热器